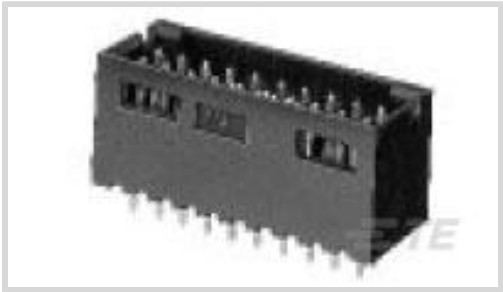




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **26**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	26
板对板配置	平行

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]



端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	制动器窗口
接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
获得 CSA 认证	是
CSA 文件号	LR7189
UL 文件号	E28476

包装特性

封装数量	128
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-87456-1
26 MODIV HSG COMP DR .100CL

TE 产品编号 1-102394-1
26 AMP MODU MT HSG DR .100CL

TE 产品编号 1-87977-1
26 MODIV HSG DR MRKD .100 POL

TE 产品编号 86177-4
26 MODIV HSG COMP DR .100CL

TE 产品编号 87743-1
MODII KEYED BARRIER INSERT

该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers

PCB 插销、锁和固定器(2)

PCB 连接器安装(1)

PCB 连接器护罩(1)

板对板接头和插座(7077)

汽车接头(10)

线到板连接器组件和护套(5)

线对板接头和插座(79)

线对板连接器端子(66)

客户还购买了

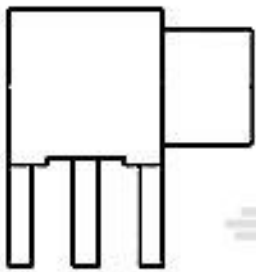
TE 产品编号1-6609027-3
10EK1=F7093 S0

TE 产品编号2-1761603-5
IDC LOW PRO HDR 14P VERT BLUE

TE 产品编号3-1393237-1
RTE24012F

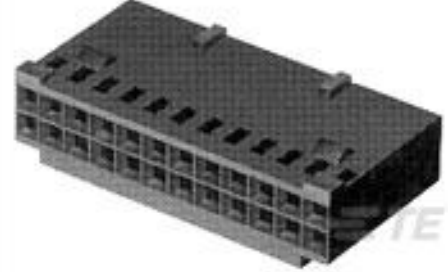
TE 产品编号1-794065-0
08P MINI UMNL HDR W/DH SN





TE 产品编号1061023-1

5864 5001 10,OSX RA PCB JACK



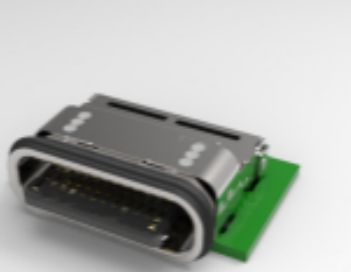
TE 产品编号2-87631-1

26 MODIV HSG COMP DR .100 POL



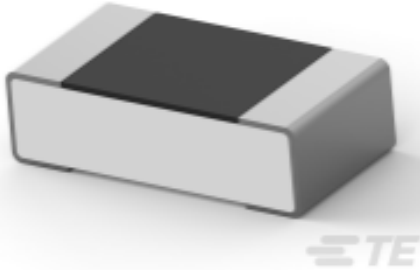
TE 产品编号282847-5

TERMI-BLOK PCB MOUNT 35 5P.5



TE 产品编号2305018-2

USB TYPE C, REC IPX8 ON BOARD DUAL SMT



TE 产品编号2176372-9

RQ 0603 60K4 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

26 MODII HDR DRST SHRD .100CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-102618-1_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-102618-1_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_6-102618-1_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5

英文版本

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

6-102618-1

AMPMODU Headers, PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 26 Position, 2.54 mm [.1in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Printed Circuit Board



英文版本